

Title (en)
PROCESS FOR COATING ELECTRICALLY CONDUCTIVE SUBSTRATES, SUBSTRATES SO OBTAINED, AND AQUEOUS ELECTROPHORETIC ENAMEL BATHS.

Title (de)
VERFAHREN ZUR BESCHICHTUNG ELEKTRISCH LEITFÄHIGER SUBSTRATE, NACH DIESEM VERFAHREN BESCHICHTETE SUBSTRATE UND WÄSSRIGE ELEKTROTAUHLACKBÄDER.

Title (fr)
PROCEDE DE REVETEMENT DE SUBSTRATS ELECTROCONDUCTEURS, SUBSTRATS REVETUS SELON CE PROCEDE ET BAINS AQUEUX DE TREMPAGE ELECTROPHORETIQUE.

Publication
EP 0386156 A1 19900912 (DE)

Application
EP 89902202 A 19881215

Priority
DE 3801787 A 19880122

Abstract (en)
[origin: EP0324951A1] A cathodic electrophoretic enamelling process is characterized in that the electrophoretic enamelling bath contains at least 7.5 wt. % of a polyoxyalkylene polyamine or a mixture of several polyoxyalkylene polyamines of differing chemical structures, the percentage by weight being expressed with respect to the total binder content in the electrophoretic enamelling bath.

Abstract (fr)
Un procédé de trempage électrophorétique cathodique se caractérise par le fait que le bain de trempage électrophorétique contient au moins 7,5 % en poids d'une polyoxyalkylènepolyamine ou d'un mélange de plusieurs polyoxyalkylènepolyamines ayant des structures chimiques diverses, le pourcentage en poids étant donné par rapport à la teneur totale en liants du bain de trempage électrophorétique.

IPC 1-7
C09D 3/58; C09D 5/44

IPC 8 full level
C08G 59/14 (2006.01); **C08L 63/00** (2006.01); **C09D 5/44** (2006.01); **C09D 163/00** (2006.01); **C25D 13/06** (2006.01); **C25D 13/10** (2006.01)

CPC (source: EP KR)
C08G 59/1444 (2013.01 - EP); **C08G 59/1483** (2013.01 - EP); **C08L 63/00** (2013.01 - EP); **C09D 5/44** (2013.01 - KR); **C09D 5/4457** (2013.01 - EP); **C09D 5/4492** (2013.01 - EP); **C09D 163/00** (2013.01 - KR)

Citation (search report)
See references of WO 8906673A1

Designated contracting state (EPC)
AT BE CH DE FR GB IT LI NL SE

DOCDB simple family (publication)
EP 0324951 A1 19890726; EP 0324951 B1 19920715; AT E78284 T1 19920815; AU 3052989 A 19890811; AU 617152 B2 19911121; BR 8807879 A 19901009; CA 1335395 C 19950425; CN 1026009 C 19940928; CN 1039074 A 19900124; DE 3801787 A1 19890727; DE 3872867 D1 19920820; EP 0386156 A1 19900912; ES 2034140 T3 19930401; JP H02503573 A 19901025; JP H083061 B2 19960117; KR 900700552 A 19900816; KR 930008750 B1 19930913; WO 8906673 A1 19890727; ZA 89252 B 19891025

DOCDB simple family (application)
EP 88120996 A 19881215; AT 88120996 T 19881215; AU 3052988 A 19881215; AU 3052989 A 19891215; BR 8807879 A 19881215; CA 588746 A 19890120; CN 89100299 A 19890120; DE 3801787 A 19880122; DE 3872867 T 19881215; EP 8801164 W 19881215; EP 89902202 A 19881215; ES 88120996 T 19881215; JP 50205989 A 19881215; KR 890701740 A 19890922; ZA 89252 A 19890112